

2011-2015年中国半导体材料行业 市场监测及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国半导体材料行业市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/xincailiao1106/C347750B3V.html>

【报告价格】 纸介版**6800**元 电子版**7000**元 纸介+电子**7200**元

【出版日期】 2011-06-10

【交付方式】 Email电子版/特快专递

【订购电话】 全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国半导体材料行业市场监测及投资前景研究报告》共十四章。首先介绍了中国半导体材料行业市场发展环境、中国半导体材料整体运行态势等，接着分析了中国半导体材料行业市场运行的现状，然后介绍了中国半导体材料市场竞争格局。随后，报告对中国半导体材料做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体材料行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体材料产业有个系统的了解或者想投资半导体材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

制备不同的半导体器件对半导体材料有不同的形态要求，包括单晶的切片、磨片、抛光片、薄膜等。半导体材料的不同形态要求对应不同的加工工艺。常用的半导体材料制备工艺有提纯、单晶的制备和薄膜外延生长。

第一章 全球半导体行业运行态势分析

第一节 2010-2011年全球半导体产业发展分析

- 一、全球半导体产业发生巨变
- 二、世界半导体产业进入整合期
- 三、全球半导体产业新进展
- 四、国际半导体市场增长减缓

第二节 2010-2011年中国半导体产业分析

- 一、中国半导体产业简要分析
- 二、中国半导体产业局势良好
- 三、两化融合促进半导体行业发展

第三节 2010-2011年中国半导体市场的发展概况

- 一、中国半导体市场分析
- 二、中国半导体市场销售收入分析
- 四、中国半导体企业市场占有率分析

第四节 2010-2011年中国半导体发展存在的问题

- 一、中国半导体产业发展面临的瓶颈
- 二、核心技术缺失阻碍中国半导体产业发展

三、中国半导体产业材料和设备严重滞后

四、中国半导体产业面临的挑战

第五节 2010-2011年中国半导体发展的策略分析

一、中国半导体产业应主动参与海外收购

二、应尽快同步发展半导体支撑材料配套业

三、中国半导体产业追求创新与创收双赢

第二章 全球半导体材料产业运行状况分析

第一节 2010-2011年国际半导体材料发展综述

一、世界半导体材料产业快速发展

二、世界半导体材料市场强劲增长

三、半导体材料市场再创新高

第二节 2010-2011年全球半导体材料产业市场动态分析

一、世界半导体封装材料规模

二、世界半导体硅材料发展现状

三、半导体材料的过去、现在和将来

第三节 2011-2015年世界半导体材料产业规模预测分析

第三章 全球半导体材料主要地区运行透析

第一节 美国

一、美国开发出新型半导体材料

二、美国开发出的新材料可降低成本

三、美国利用钴绿开发新半导体材料

四、美国道康宁推出半导体材料发展新模式

第二节 日本

一、日本开发出微磁性半导体材料

二、日本开发出钻石半导体材料

三、日本有机半导体材料电子迁移率高

四、日本半导体材料巨头加大投资以增产

第三节 中国台湾

一、台湾跃登全球半导体材料第二大市场

二、台湾硅晶圆市场快速成长

三、台湾成为最大半导体设备投资市场

四、台湾建成半导体材料实验室

第四章 半导体材料产业运行环境分析

第一节 国内半导体材料经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2011年中国半导体材料经济发展预测分析

第二节 中国半导体材料行业政策环境分析

第五章 中国半导体材料产业运行形势分析

第一节 2010-2011年中国半导体材料行业发展综述

一、中国是最受关注的半导体材料市场

二、半导体材料的发展状况分析

三、半导体材料市场需求巨大

四、国产半导体材料新品不断

第二节 2010-2011年中国半导体材料的研究应用状况

一、半导体材料的研究主题

二、中国半导体材料的研究进展

三、半导体材料的应用分析

四、绿色半导体材料应用于高温汽车

第三节 2010-2011年中国半导体材料发展中存在的问题及建议

一、新材料产生的污染问题

二、中国半导体材料业应开拓创新

三、发展中国半导体材料的几点建议

第六章 中国半导体硅材料产业运行动态分析

第一节 2010-2011年中国硅材料业的发展分析

一、半导体硅材料产业迅猛发展

二、乐山市硅材料产业迅速崛起

三、中国半导体硅材料行业发展的新特点

第二节 2010-2011年中国半导体硅材料发展中的问题

- 一、技术落后阻碍半导体硅材料发展
- 二、六大问题制约高纯硅材料产业发展
- 三、多晶硅价格居高不下给国内企业带来压力

第三节 2010-2011年中国半导体硅材料的发展对策

- 一、加快半导体硅材料行业发展的建议
- 二、发展硅材料行业的策略
- 三、国内硅材料企业的竞争策略

第七章 中国半导体材料氮化镓产业运行走势分析

第一节 第三代半导体材料相关概述

- 一、第三代半导体材料的发展历程
- 二、第三代半导体材料得到推广
- 三、宽禁带半导体材料

第二节 2010-2011年中国氮化镓的发展概况

- 一、氮化镓半导体材料市场的发展状况
- 二、氮化镓照亮半导体照明产业
- 三、GaN蓝光产业的重要影响

第三节 2010-2011年中国氮化镓的研发和应用状况

- 一、中科院研制成功氮化镓基激光器
- 二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化
- 三、非极性氮化镓材料的研究有进展
- 四、氮化镓的应用范围
- 五、氮化镓晶体管的应用分析

第八章 中国其他半导体材料产业市场局势分析

第一节 砷化镓

- 一、砷化镓单晶材料的发展
- 二、砷化镓的特性
- 三、砷化镓产业的发展应用状况
- 四、中国最大的砷化镓材料生产基地投产

第二节 碳化硅

- 一、半导体材料碳化硅介绍

- 二、碳化硅材料的特性
- 三、高温碳化硅制造装置的组成
- 四、中国碳化硅的研发与产业化项目取得重大突破

第九章 中国半导体材料产业市场竞争格局分析

第一节 2010-2011年中国半导体材料产业竞争现状分析

- 一、半导体材料竞争力分析
- 二、世界两大半导体材料厂商投资竞争
- 三、半导体材料竞争无线应用领域

第二节 2010-2011年中国半导体材料产业区域格局分析

- 一、重点生产企业集中分布
- 二、市场消费区域竞争力分析
- 三、重点省市对比分析

第三节 2010-2011年中国半导体材料产业提升竞争力策略分析

第十章 国外半导体材料优势企业经营状况解析

第一节 信越化学工业株式会社

- 一、公司简介
- 二、信越化学工业株式会社经营状况
- 三、公司竞争力分析

第二节 WACKER CHEMIE

- 一、公司简介
- 二、Wacker公司经营状况
- 三、公司竞争力分析

第三节 三菱住友株式会社（SUMCO）

- 一、公司简介
- 二、三菱住友经营状况分析
- 三、公司竞争力分析

第十一章 中国半导体材料重点企业竞争力分析

第一节 有研半导体材料股份有限公司

- 一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

四、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 天津中环半导体股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

四、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 浙江海纳科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

四、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 峨眉半导体材料厂

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

四、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 洛阳中硅高科有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

四、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节 北京国晶辉红外光学科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

四、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 北京中科镓英半导体有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

四、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节 上海九晶电子材料有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

四、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九节 东莞钛升半导体材料有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

四、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十节 河南新乡华丹电子有限责任公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

- 三、企业盈利能力分析
- 五、企业偿债能力分析
- 四、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第十二章 中国半导体材料相关行业分析

第一节 半导体分立器件

- 一、半导体分立器件市场稳健发展
- 二、国内半导体分立器件的发展热点
- 三、以新思维发展半导体分立器件产业
- 四、半导体分立器件未来的三大发展特点
- 五、半导体分立器件产量数据统计分析

第二节 半导体集成电路

- 一、集成电路产业的发展状况
- 二、中国各地区半导体集成电路发展概况
- 三、半导体集成电路发展需创新
- 四、集成电路产业的错位竞争策略
- 五、2011年中国集成电路产业规模将突破1万亿元
- 六、集成电路产量数据统计分析

第三节 LED产业

- 一、LED在中国的发展
- 二、中国LED产业形成新格局
- 三、中国LED市场混乱
- 四、半导体照明LED产业前途光明
- 五、中国LED产业产值预测

第十三章 2011-2015年中国半导体材料的发展趋势预测分析

第一节 2011-2015年中国半导体产业的前景分析

- 一、中国半导体产业前景光明
- 二、中国大陆将占世界半导体市场1/3
- 三、半导体设备业前景分析
- 四、半导体技术发展的低耗能趋势

第二节 2011-2015年中国半导体材料产业发展趋势分析

一、半导体材料的发展趋势

二、化合物半导体材料市场预测

三、半导体清模材料的发展趋势

四、利用半导体材料开发新能源的前景

第三节 2011-2015年中国半导体材料产业市场预测分析

第十四章 2011-2015年中国半导体材料产业投资机会与风险分析

第一节 2011-2015年中国半导体材料产业投资环境分析

一、宏观经济预测分析

二、金融危机影响分析

第二节 2011-2015年中国半导体材料产业投资机会分析

第三节 2011-2015年中国半导体材料产业投资风险分析

一、市场运营风险

二、技术风险

三、政策风险

四、原材料风险

五、进入退出风险

图表目录（部分）：

图表：2005-2011年国内生产总值

图表：2005-2011年居民消费价格涨跌幅度

图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2005-2011年国家外汇储备

图表：2005-2011年财政收入

图表：2005-2011年全社会固定资产投资

图表：2011年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力

图表：主要半导体材料的比较

图表：半导体材料的主要用途

图表：GAAS单晶生产方法比较

图表：有研半导体材料股份有限公司主要经济指标走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司经营收入走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司盈利指标走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司负债情况图

图表：有研半导体材料股份有限公司负债指标走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司运营能力指标走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司成长能力指标走势图

图表：天津中环半导体股份有限公司主要经济指标走势图

图表：天津中环半导体股份有限公司经营收入走势图

图表：天津中环半导体股份有限公司盈利指标走势图

图表：天津中环半导体股份有限公司负债情况图

图表：天津中环半导体股份有限公司负债指标走势图

图表：天津中环半导体股份有限公司运营能力指标走势图

图表：天津中环半导体股份有限公司成长能力指标走势图

图表：浙江海纳科技股份有限公司主要经济指标走势图

图表：浙江海纳科技股份有限公司经营收入走势图

图表：浙江海纳科技股份有限公司盈利指标走势图

图表：浙江海纳科技股份有限公司负债情况图

图表：浙江海纳科技股份有限公司负债指标走势图

图表：浙江海纳科技股份有限公司运营能力指标走势图

图表：浙江海纳科技股份有限公司成长能力指标走势图

图表：峨眉半导体材料厂主要经济指标走势图

图表：峨眉半导体材料厂经营收入走势图

图表：峨眉半导体材料厂盈利指标走势图

图表：峨眉半导体材料厂负债情况图

图表：峨眉半导体材料厂负债指标走势图

图表：峨眉半导体材料厂运营能力指标走势图

图表：峨眉半导体材料厂成长能力指标走势图

图表：洛阳中硅高科有限公司主要经济指标走势图

图表：洛阳中硅高科有限公司经营收入走势图

图表：洛阳中硅高科有限公司盈利指标走势图

图表：洛阳中硅高科有限公司负债情况图

图表：洛阳中硅高科有限公司负债指标走势图

图表：洛阳中硅高科有限公司运营能力指标走势图

图表：洛阳中硅高科有限公司成长能力指标走势图

图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司主要经济指标走势图

图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司经营收入走势图

图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司盈利指标走势图

图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司负债情况图

图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司负债指标走势图

图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司运营能力指标走势图

图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司成长能力指标走势图

图表：北京中科镓英半导体有限公司主要经济指标走势图

图表：北京中科镓英半导体有限公司经营收入走势图

图表：北京中科镓英半导体有限公司盈利指标走势图

图表：北京中科镓英半导体有限公司负债情况图

图表：北京中科镓英半导体有限公司负债指标走势图

图表：北京中科镓英半导体有限公司运营能力指标走势图

图表：北京中科镓英半导体有限公司成长能力指标走势图

图表：上海九晶电子材料有限公司主要经济指标走势图

图表：上海九晶电子材料有限公司经营收入走势图

图表：上海九晶电子材料有限公司盈利指标走势图

图表：上海九晶电子材料有限公司负债情况图

图表：上海九晶电子材料有限公司负债指标走势图

图表：上海九晶电子材料有限公司运营能力指标走势图

图表：上海九晶电子材料有限公司成长能力指标走势图

图表：东莞钛升半导体材料有限公司主要经济指标走势图

图表：东莞钛升半导体材料有限公司经营收入走势图

图表：东莞钛升半导体材料有限公司盈利指标走势图

图表：东莞钛升半导体材料有限公司负债情况图

图表：东莞钛升半导体材料有限公司负债指标走势图

图表：东莞钛升半导体材料有限公司运营能力指标走势图

图表：东莞钛升半导体材料有限公司成长能力指标走势图

图表：河南新乡华丹电子有限责任公司主要经济指标走势图

图表：河南新乡华丹电子有限责任公司经营收入走势图

图表：河南新乡华丹电子有限责任公司盈利指标走势图

图表：河南新乡华丹电子有限责任公司负债情况图

图表：河南新乡华丹电子有限责任公司负债指标走势图

图表：河南新乡华丹电子有限责任公司运营能力指标走势图

图表：河南新乡华丹电子有限责任公司成长能力指标走势图

图表：……

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/xincailiao1106/C347750B3V.html>